

证券代码:600076

证券简称:康欣新材

公告编号:2026-016

康欣新材料股份有限公司

关于收购无锡宇邦半导体科技有限公司部分股权进展

暨完成工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、基本情况概述

康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月11日召开了第十二届董事会第四次会议，审议通过了《关于收购无锡宇邦半导体科技有限公司部分股权并对其增资方案调整的议案》，公司拟通过受让股权加增资的方式取得无锡宇邦半导体科技有限公司（以下简称“宇邦半导体”）55%股权，具体内容详见公司于2026年2月12日在上海证券交易所网站披露的《康欣新材料股份有限公司关于收购无锡宇邦半导体科技有限公司部分股权并对其增资方案调整的公告》（公告编号：2026-010）。

2026年3月23日，公司收购宇邦半导体部分股权事项已获得无锡市国资委的批复，原则同意公司通过股权受让和增资方式取得宇邦半导体55%的股权。具体内容详见公司于2026年3月26日在上海证券交易所网站披露的《康欣新材料股份有限公司关于收购无锡宇邦半导体科技有限公司部分股权并对其增资事项获得国资委批复的进展公告》（公告编号：2026-014）。

二、工商变更登记情况

近日，宇邦半导体已完成相关的工商变更登记手续，并取得了无锡市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体信息如下：

名称	无锡宇邦半导体科技有限公司
类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人	汤晓超
统一社会信用代码	913202143240182668
注册资本	2454.8643 万元整
成立日期	2014 年 12 月 10 日
住所	无锡市新吴区长江南路 35-106
经营范围	一般项目：半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；半导体分立器件制造；半导体分立器件销售；软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通机械设备安装服务；电子产品销售；电子专用材料销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；专用设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；电子专用设备销售；电子专用设备制造；电子元器件制造；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

特此公告。

康欣新材料股份有限公司

董事会

2026年4月8日